

有研半导体硅材料股份公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 本次重大资产重组的基本情况

● 有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购高频（北京）科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）约 60%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后公司将成为标的公司控股股东。

● 本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

二、 本次重大资产重组的进展情况

2025 年 3 月 4 日，公司与标的公司及其股东许又志、王霞、王晓签署了《有研半导体硅材料股份公司关于高频（北京）科技股份有限公司股份收购之意向性协议》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《有研半导体硅材料股份公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股份收购意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-002）。

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

三、 风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实

施及实施的具体进度均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025 年 4 月 8 日